

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 基板の研磨終点を正確に決定することができる研磨方法が開示される。本方法は、研磨パッドを支持する研磨テーブルを回転させ、研磨ヘッドによって基板を研磨パッドの研磨面に押し付けて基板を研磨し、基板Wを研磨する工程は、研磨ヘッドを研磨面に沿って揺動させながら基板Wを研磨する揺動研磨工程と、研磨ヘッドの揺動を停止させた状態で基板Wを研磨する静止研磨工程とを含み、静止研磨工程は、
- 10 揺動研磨工程後に行われ、静止研磨工程は、研磨テーブルを回転させるためのトルクの変化の割合が変化割合しきい値に達した時点である静止研磨終点を決定する工程を含む。

図 4